



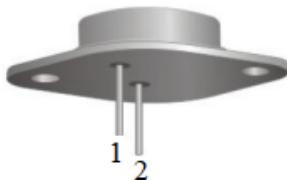
硅肖特基二极管

2DK3100 型硅肖特基整流二极管

1、特性

芯片采用硅外延平面结构，器件采用 B2-01B 型金属封装，典型重量 8.9g。

器件具有正向导通损耗小、正向压降低等特点，在电子电路中能起到开关、整流、续流等多种作用；器件的静电放电敏感度为 3A 级 4000V。



极性标志说明：1、2—正极，3—负极

2、质量等级及执行标

G、G+级，Q/RBJ1008QZ，QZJ840611。

3、最大额定值

器件额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^\circ\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

型 号	I_{FM} (A)		V_{BR} V	V_{RWM} V	I_{FSM} A	T_j $^\circ\text{C}$	T_{stg} $^\circ\text{C}$
	$T_C=75^\circ\text{C}$						
2DK3100	3	100	80	30	-55~150	-55~150	

4、主要电特性

主要电特性（除另有规定外， $T_A=25^\circ\text{C}$ ）见表 2。

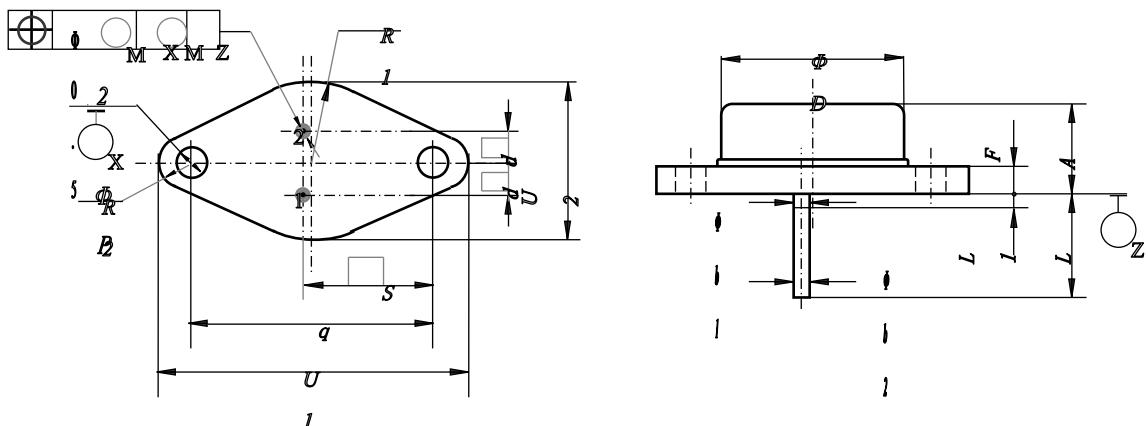
表 2 主要电特性

型号	电参数	测试 条 件	极 限 值		单 位
			最 小	最 大	
2DK3100	V_{FM}	$I_F=3\text{A}$	—	0.55	V
	I_R	$V_R=64\text{V}$	—	10	μA
	V_{BR}	$I_R=0.1\text{mA}$	100	—	V



硅肖特基二极管

5、外形尺寸



极性标志说明：1、2—负极，3—正极

尺寸符号	最小值	典型值	最大值
A			9.8
ϕb_1			1.52
ϕb_2	0.9		1.1
ϕD			15.0
d		3.0	
F			3.0
L	8.5		10.5
L_1			1.5
ϕP	4.0		4.2
q	22.8		23.2
R_1			9.5
R_2			4.3
S		13.1	
U_1			31.4
U_2			19.0

图 1 UB 外形图

6、使用和维护

6.1 器件的安装

安装质量的好坏对器件的可靠性影响很大。, 在安装、测试等过程中轻拿轻放, 避免碰撞、重物碾压, 否则易造成陶瓷金属裂缝, 影响其密封性。

焊接安装时, 器件允许耐焊接热的条件是温度 260℃下不超过 10 秒; 浸锡温度不超过 260℃, 时间不超过 10 秒。

6.2 器件的使用

测试或筛选时应严格按规定条件、方法进行, 应使用合格的设备、仪器仪表, 并对其进行校验; 操作人员必须持证上岗, 必要时要进行专门培训。

严禁超规范使用, 注意防潮、防尘, 严禁裸手直接接触器件。

测试设备、仪器仪表可靠接地。

测试过程中应采取静电防护措施。

如发生不可预期情况或误操作造成器件损坏等情况, 请与供应商联系。